《MEMS/MOEMS封装技术》阅读笔记

MEMS制造工艺包括：光刻图形、湿法腐蚀、等离子刻蚀、反应离子刻蚀、深反应离子刻蚀（DRIE）、反应离子束刻蚀（RIBE）、离子铣、电镀、成型、铸造、微电火花加工（EDM）、激光微加工、光刻胶、坚膜与显影、晶圆键和、晶圆级封装。